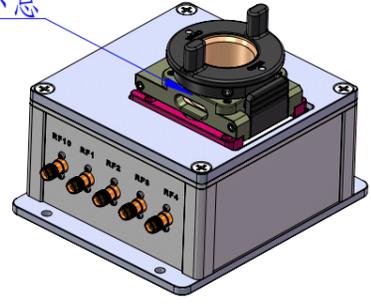


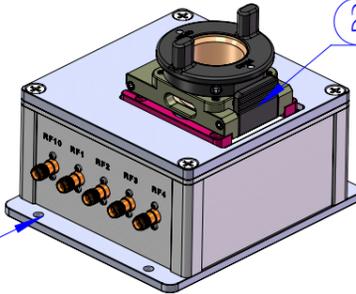
版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	Steven.Wang	2025/3/7

图纸编号  
12.03.RF-002820

芯片安装示意

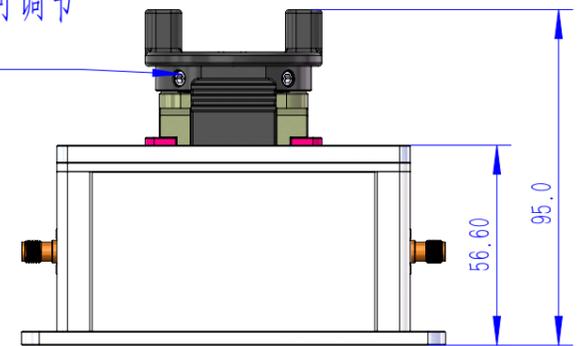


① 外延安装孔  
方便机架安装



② 搭扣自锁

③ 锁紧扭力可调节  
避免压伤芯片

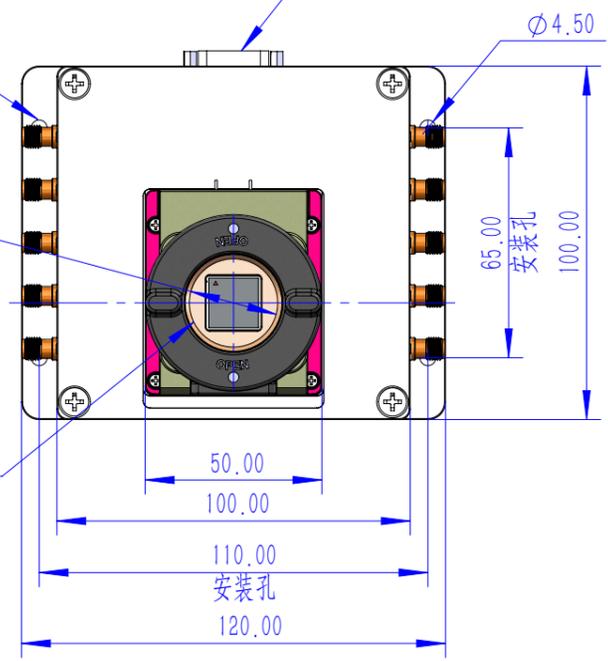


J30J

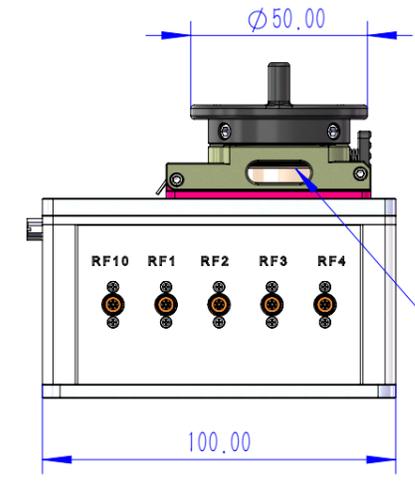
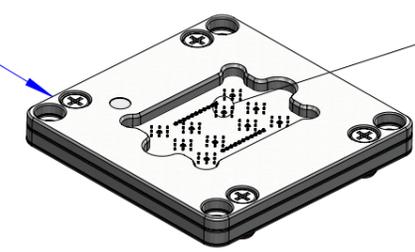
2.92 母头输出

Ø25.00  
(开窗孔)

④ 大开窗,  
便于观察调试

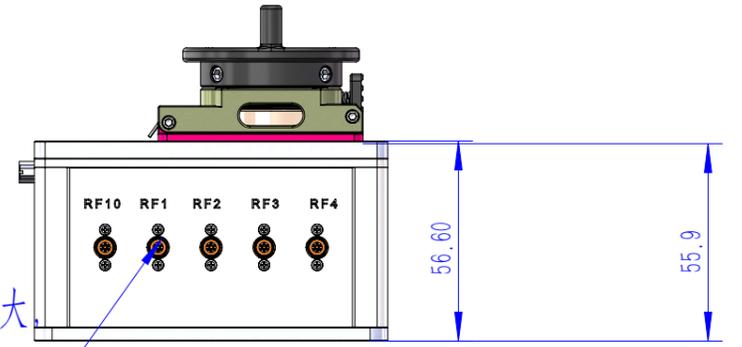


⑤ 不锈钢全金属BGA 托盘  
良好散热/微同轴传输



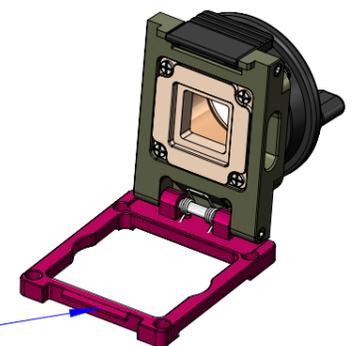
⑧ 垂直压盖, 保证压接触紧密  
无需调整, 重复一致性好

⑥ 接口间距大,  
方便安装



⑨ 定制双头高频弹簧针  
长寿命/低感/频率40GHz

⑦ 独立压盖机构, 可移除,  
方便自动测试机台使用



一、电气特性	
阻抗 (欧姆):	50
频率 (GHz):	0-30
接触电阻 (mΩ):	
内部接触:	≤100
外部接触:	≤50
电压驻波比:	≤1.35 (0-18GHz) ≤1.65 (18-30GHz)
通道相位一致性:	≤8° (DC40GHz)
通道隔离度:	≥90dB
插入损耗 (dB, f/GHz):	≤-1.5dB
二、机械性能	
耐久性 (次):	1000
弹簧针寿命 (次):	≥10W

接口耐久性 (次):	1000
连接器材料及电镀:	
主体	黄铜镀金
中心针	镀铜镀金
介质	PEI
其他金属零件	黄铜镀金
壳体	不锈钢/铝合金
三、环境属性	
温度范围:	-55°C - +125°C
热冲击:	MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B
振动:	MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B
冲击:	MIL-STD 202G, Meth.213, Cond I
气候等级:	IEC 60068 40/125/56
RoHS:	Compliant

版本	00	比例	1:2	设计	SS.Z
除非另有规定		标记阶段		设计日期	2024/4/30
所有尺寸单位均为mm		P		审核	XK.L
机加工表面光洁度最大为1.6 RMS,				审核日期	2024/4/30
去除所有毛刺, 最大0.15X45°				批准	HN.W
倒角, 最大0.15X45°				批准日期	2024/4/30
圆角, 最大R0.1					
小数公差					
.X±0.15   .XX±0.05					
角度±2°					
不要在图上量取尺寸					



上海军友  
射频技术有限公司

描述  
MEA-BGA30-031  
BGA Socket, DC~30GHz, RF 10 Channels

图号  
12.03.RF-002820